

证券代码：688167

证券简称：炬光科技

西安炬光科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-003

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>投资者现场调研</u> ）
参与单位名称及人员姓名	6月参加公司现场调研的投资者（见附件）
会议时间	2026年6月1日-6月30日
会议地点	西安炬光科技股份有限公司
上市公司接待人员姓名	董事、董事会秘书、市场总监：张雪峰 女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问：公司最近披露了《关于子公司签订技术许可协议的公告》。请问公司为何选择以技术许可方式授权微棱镜透镜阵列和垂直光学耦合器相关技术，而非直接销售相关产品？</p> <p>答：关于本次技术许可事项，公司已在相关公告中进行了详细披露，请以公告内容为准。</p> <p>本次许可并非单纯的技术转让，而是“以许可促研发”的战略协同。公司技术团队将深度参与基于该技术的联合开发项目，通过接触国际头部客户在AI算力、数据中心等领域的前沿需求，加速自身技术迭代，持续提升公司在微纳光学领域的技术创新能力和核心竞争力。</p> <p>通过向AH公司授权该技术，将有效助力公司在CPO（共封装光学）光互联领域所参与的边缘耦合技术路线实现规模化的推广。依托AH公</p>

司及其下游生态的市场渗透力，公司将显著拓宽该技术的应用边界，从而吸纳并覆盖更广泛的潜在客户群体，进一步巩固公司在光互联产业链中的核心地位。

问：公告中提及特许权使用费按照“件”进行计费，请问“件”具体指什么？

答：“件”是协议约定的产品销售计量单位，即 AH 公司采用公司许可的技术对应生产的产品，每销售一个计为一件，并据此计算相应特许权使用费。

问：目前市场预计 NPO 产业正在加速发展，请问公司针对 NPO 应用布局的产品是否进入相关产业链生态体系？

答：公司认为，NPO（近封装光学）是从可插拔向 CPO 演进的过渡技术方案。从供应链角度看，NPO 并非颠覆性的全新体系，而是基于传统可插拔光模块供应链，向“硅光+光引擎+交换机封装”方向的升级演进。因此，在微光学元器件及衬底材料等核心环节，公司目前在可插拔光模块的供应链地位与客户资源具有极高的复用性，公司不仅能够无缝承接 NPO 带来的增量需求，更能依托现有技术优势，积极适配 NPO 等新形态的技术需求，实现业务的持续增长。

问：请问产业链上游高速有源光芯片供应情况是否会对公司光通信领域相关业务出货量产生影响？

答：公司目前在光通信业务的收入主要来自于可插拔光模块领域。在该领域，我们提供单透镜或透镜阵列（1x4 或 1x8 等）等无源光学元器件。材料上，既有玻璃材质，也有硅材质。功能主要是用于激光到光纤的耦合、光纤到硅光集成芯片耦合，适用于传统光模块自由空间 CWDM，以及硅光模块，支持所有速率：100G、400G、800G、1.6T、3.2T 等。

但是，下游光模块客户整机交付需同时配套高速有源光芯片，目前行业对有源光芯片整体需求旺盛，部分高端有源芯片仍存在供应偏紧的情况。受此影响，可能对部分客户的生产计划和交付节奏产生一定影响，进而影响客户对无源光学元器件的提货进度。

总体来看，公司看好光通信行业的长期发展机遇，但相关业务未来放量速度及业绩贡献除受市场需求和客户导入进展影响外，也与产业链整体供给情况密切相关，存在一定不确定性。公司将持续加强与客户及产业链伙伴的协同合作，积极把握行业发展机会。

问：公司的衬底材料是否可以应用于光通信领域？目前进展如何？

答：随着 AI 数据中心、高速光模块（800G/1.6T）以及硅光、CPO 等技术的发展，行业对激光器和光子器件封装在散热性能、可靠性和集成度方面提出了更高要求。

基于公司在高功率半导体激光器封装材料领域多年的技术积累，公司开发的高性能散热衬底材料具备优异的导热和热管理能力，可应用于光通信领域相关场景，特别是在硅光模块 CW 激光器、CPO 外置激光光源等对散热要求较高的应用中具有较好的适配性。这也是公司核心材料技术向光通信领域的重要延伸方向之一。

其中，公司预制金锡薄膜氮化铝衬底具备优异的散热性能、高可靠互连能力及高密度集成能力，与新一代光通信封装的发展趋势高度契合。公司高度重视该市场机会，目前正积极与产业链客户开展技术交流和方案验证，推进客户导入及市场拓展工作。未来，公司有望受益于高速光互连、硅光及 CPO 等技术的发展趋势。

问：公司如何看待 1060nm VCSEL 在 AI Scale-Up 光互连中的发展机会？Polymer-on-Glass (PoG) 微光学技术在其中发挥什么作用？

答：公司认为，随着 AI 集群规模持续扩大，Scale-Up 网络对低成本、高带宽、高密度且可规模化部署的短距离光互连方案需求正在快速增长。在这一背景下，1060nm VCSEL 凭借更优的光纤传输特性、更好

的信号完整性以及对未来更高通道数架构的支持能力，有望成为 AI Scale-Up 场景的重要技术路线之一。

从应用端看，1060nm VCSEL 主要面向服务器内部、机架内部以及相邻机架之间的短距离光互连，并有望应用于未来 800G、1.6T 及更高速率 AOC 产品。随着 AI 集群内部光链路数量快速增长，市场对于低成本、高密度、可量产光互连方案的需求将持续提升。

在这一过程中，Polymer-on-Glass (PoG) 微光学技术发挥着关键作用。PoG 采用晶圆级制造工艺，在玻璃基板上压印树脂材料形成高精度微透镜阵列，与 VCSEL 晶圆进行晶圆级组装，或者直接在 VCSEL 晶圆压印树脂微透镜阵列，从而实现 VCSEL 阵列到光纤阵列的高效耦合，提升耦合效率和制造良率，并支持高密度光学集成与规模化生产。依托公司在晶圆级微光学领域多年的技术积累，公司认为 PoG 技术有望成为未来 AI 短距光互连产业链中的关键使能技术之一，并为公司带来新的市场机会。

问：如何看待康宁的玻璃桥方案对公司 CPO 业务的影响？

答：公司定位于 CPO 产业链中的元器件供应商，目前产品已深入布局以下四大环节：

1、外置激光光源 (ELSFP) 模块：提供快慢轴一体准直透镜（用于激光芯片的高精度光束准直）及高性能热沉材料（采用氮化铝陶瓷衬底，专为芯片高效散热设计）。

2、光纤阵列单元 (FAU)：提供超高通道密度 V 型槽阵列，满足高密度光纤互连的需求。

3、PIC-FAU 光连接 (FAU 端)：提供透镜反射镜阵列，分别适配边缘耦合与光栅耦合两种技术方案。

4、PIC-FAU 光连接 (PIC 端)：提供微棱镜透镜阵列，用于边缘耦合技术方案中实现 PIC-FAU 的高效光互联。

针对康宁的 Glass Bridge 方案，我们认为其对公司业务不构成替代关系，更多是潜在的互补或共存。在部分光纤-PIC 的耦合应用场景下，

例如无需进行光路转折、通道数较少的设计，有可能成为一种可选的实现方案，与现有方案更多体现为互补关系，而非完全替代。

从行业发展来看，目前 CPO 的光耦合技术路线尚未形成统一标准，多种方案仍处于并行发展阶段。未来不同技术方案的市场空间，更多取决于产业成熟度、客户产品架构以及实际应用需求，不太可能由单一方案完全取代其他方案。

总体而言，我们认为，新技术、新方案的不断出现，反映的是 CPO 产业正在持续创新和快速发展。公司目前已在 CPO 多个关键环节实现产品布局，能够受益于整个产业的发展。因此，现阶段我们并不认为康宁 Glass Bridge 方案会对公司的 CPO 业务产生实质性的负面影响。

问：公司消费电子业务目前进展如何？

答：目前公司消费电子业务收入占比仍然较小，由于尚未进入规模化量产阶段，尚未形成显著收入贡献，对公司整体经营业绩影响有限。一季度消费电子业务同比增长较快，主要受上年同期基数较低影响。

消费电子行业通常具有较长的导入周期，从技术验证、产品开发到最终量产往往需要经历多个阶段。需要说明的是，公司收购 Heptagon 相关资产属于资产收购而非股权收购，不包含原有客户和业务，因此需要依托相关技术和制造能力重新开拓市场和客户。

经过过去一年多的整合与市场拓展，公司已在消费电子领域取得部分进展，相关项目正按计划推进。公司期待首个量产项目能够尽快实现落地，但该项目规模相对有限。消费电子业务从项目导入到形成规模化收入通常需要较长时间，未来对公司的贡献将是一个逐步积累和释放的过程。

问：除光通信、消费电子以外，公司的传统业务情况如何？

答：公司传统业务整体保持稳健发展，是公司当前收入、利润和现金流的重要来源。近年来，公司持续推进业务结构优化，主动减少部分

	<p>竞争优势不明显、盈利水平较低的业务，将资源进一步聚焦于具有技术壁垒和盈利能力优势的核心业务领域。</p> <p>从发展阶段来看，公司传统业务整体已进入相对成熟阶段，未来收入预计将保持总体稳定，但不会成为公司未来主要的增长来源。其中，汽车业务收入主要来源于已获取定点项目的量产交付。由于部分前期项目逐步进入生命周期后期，以及激光雷达相关定点项目已全部取消，在缺乏同等规模新项目接续的情况下，汽车业务收入未来存在一定下滑压力。与此同时，工业、医疗及泛半导体等业务整体保持稳健发展。</p> <p>公司更加关注业务质量和盈利能力。通过持续优化产品结构、推进制造降本增效等措施，传统业务整体仍具备良好的盈利能力和现金创造能力，将继续发挥公司“现金牛”业务的作用，为光通信、消费电子等新兴业务的发展提供稳定的利润和现金流支持。</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>参与单位名称及人员姓名</p>
<p>日期</p>	<p>2026年6月1日-6月30日</p>

参与单位名称及人员姓名:

序号	参会人	机构名称
1	艾邦妮	华夏基金
2	曹苍剑	中信证券资管
3	曹佳维	陕西省引导基金
4	陈诚	兴合基金
5	陈静	中加基金
6	陈伟冬	璟澄资本
7	陈祥	天弘基金
8	陈向阳	个人投资者
9	陈亚强	和信证券
10	程乙峰	西部证券
11	崔璟	璟澄资本
12	方彦	泾溪投资
13	费征帅	鸿竹资产
14	冯雨淇	银河证券
15	付子豪	陕西九九投资集团
16	高记鹏	开源证券
17	耿荣晨	财通证券
18	郭东谋	南方基金
19	郭倩倩	招商证券
20	郭仕源	个人投资者
21	胡鸿轲	上海行疆/上海喜安
22	惠旭升	东方财富
23	蒋捷	华商基金
24	康志毅	天风证券
25	雷科	开源证券
26	李大和	中信证券资管
27	李迪心	上海汐泰投资
28	李芬	东方财富
29	李金哲	南方基金
30	李培玉	山证资管
31	李新航	国新投资
32	李洋	兆顺基金
33	凌晨	歌汝私募
34	刘海彬	新华基金
35	刘嘉元	百年保险资管
36	刘云	财通证券
37	罗毅超	中信证券资管
38	吕明晖	鑫泽投资
39	马川	合远基金

序号	参会人	机构名称
40	马伟恩	华夏基金
41	欧子兴	东吴证券
42	潘敏	陕西九九投资集团
43	邵伟	健顺投资
44	邵萱	宁银理财
45	沈犁	财通基金
46	师正浩	开源自营
47	滕冠兴	工银瑞信
48	万斌	个人投资者
49	汪泉	东方财富
50	王焯	东方红基金
51	王平安	个人投资者
52	王泉涌	冲积资管
53	魏刚	农银汇理
54	吴雨佳	盛宇投资
55	吴兆华	征金资本
56	谢培风	国泰基金
57	熊正寰	中庚基金
58	许智涵	复需投资
59	阎飞	个人投资者
60	战信荣	中信证券资管
61	张家宇	中信证券资管
62	张锴	上海益和源资产
63	张乐妮	东方财富
64	张力琦	中信证券资管
65	张琦佳	兆顺基金
66	张文丰	鸿途私募
67	赵兵兵	中信证券资管
68	赵良毕	银河证券
69	赵屿	华安基金
70	赵中兴	银河证券
71	郑艺	璟澄资本
72	郑哲婧	昊晟投资
73	钟思文	昊晟投资
74	周诗琪	财通证券